

有關本公司的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2019年8月26日在中國成立為一家有限責任公司，並於2024年12月5日根據中國法律改制為股份有限公司。截至最後實際可行日期，本公司註冊股本為人民幣17,041,654元。

本公司的香港營業地點為上環永樂街60-66號昌泰商業大廈5樓504室，於2025年10月3日根據公司條例第16部於香港註冊為一家非香港公司。本公司的聯席公司秘書夏正靜女士已獲委任為我們的授權代表，負責於香港接收法律程序文件，其通訊地址與我們的香港營業地點相同。

2. 本公司股本變動

於2019年8月26日，本公司成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣3,000,000元。

於2023年11月21日，本公司註冊資本從人民幣15,000,000元增至人民幣16,284,247元。

於2024年5月20日，本公司註冊資本由人民幣16,284,247元增至人民幣16,852,302元。

於2025年9月8日，本公司註冊資本由人民幣16,852,302元增至人民幣17,041,654元。

有關進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構」。除上文所披露者外，我們的股本於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

3. 附屬公司股本變動

截至最後實際可行日期的附屬公司載於本文件「歷史、發展及公司架構」一節。

於2026年3月10日，香港瑤芯微電子有限公司根據香港法例註冊成立為有限公司，初始註冊資本為10,000港元。

除上文披露者外，我們的附屬公司於緊接本文件日期前兩年內概無變動。

4. 股東決議案

根據本公司於2025年9月10日舉行的股東會，股東通過以下決議案(其中包括)：

- (a) 由本公司發行每股面值人民幣0.1元的H股，並將該等H股於香港聯交所[編纂]；
- (b) 將予發行的H股數目不得超過本公司經[編纂]擴大後已發行股本總額的100%(並無計及因[編纂]獲行使而可能配發及發行的H股)，且授予[編纂](或其代表)不超過根據[編纂]發行的H股數目15%的[編纂]；
- (c) 本公司每股面值人民幣1.00元的股份將拆細為十股每股面值人民幣0.10元的股份，於股份拆細後，本公司註冊股本(即人民幣17,041,654元)將分為170,416,540股股份，於[編纂]生效；
- (d) 待[編纂]完成後，採納將於[編纂]生效的公司章程，並授權董事會根據相關法律及法規與上市規則的規定修訂公司章程；及
- (e) 授權董事會處理有關(其中包括)H股發行及[編纂]的所有相關事項。

有關本公司業務的進一步資料

1. 重大合約概要

我們已於緊接本文件日期前兩年內訂立如下屬或可能屬重大的合約(並非日常業務過程中訂立的合約)：

- (a) [編纂]。

附錄六

法定及一般資料

2. 知識產權

(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的商標：

序號	擁有人	註冊編號	註冊地	商標	類別	有效期
1.	本公司	82466333	中國		9	2025年6月7日至 2035年6月6日
2.	本公司	82455739	中國		42	2025年6月7日至 2035年6月6日
3.	本公司	82451620	中國		42	2025年6月7日至 2035年6月6日
4.	本公司	82463743	中國		9	2025年6月7日至 2035年6月6日
5.	本公司	73569994	中國		42	2025年3月14日至 2035年3月13日
6.	本公司	73921946	中國		42	2024年3月7日至 2034年3月6日
7.	本公司	73926516	中國		9	2024年3月7日至 2034年3月6日
8.	本公司	73556166	中國		9	2024年2月14日至 2034年2月13日
9.	本公司	73555595	中國		42	2024年2月14日至 2034年2月13日
10.	本公司	73553093	中國		9	2024年2月14日至 2034年2月13日
11.	本公司	73567038	中國		42	2024年2月14日至 2034年2月13日
12.	本公司	73566219	中國		42	2024年2月14日至 2034年2月13日

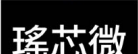
附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	註冊編號	註冊地	商標	類別	有效期
13.	本公司	73556175	中國		9	2024年2月14日至 2034年2月13日
14.	本公司	73548597	中國		9	2024年2月14日至 2034年2月13日
15.	本公司	62263542	中國		9	2022年10月28日至 2032年10月27日
16.	本公司	62204658	中國		42	2022年9月21日至 2032年9月20日
17.	本公司	49514418	中國		9	2021年6月7日至 2031年6月6日
18.	本公司	49521534	中國		42	2021年4月28日至 2031年4月27日
19.	本公司	306992056	香港	<p>A</p>  <p>B</p>  <p>C</p>  <p>D</p> 	9, 35, 42	2025年8月11日至 2035年8月10日
20.	本公司	306993460	香港	<p>A</p>  <p>B</p>  <p>C</p>  <p>D</p> 	9, 42	2025年8月12日至 2035年8月11日

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	註冊編號	註冊地	商標	類別	有效期
21.	本公司	306993479	香港		9, 42	2025年8月12日至 2035年8月11日

B
瑤芯微

C
瑤芯微

D
瑤芯微

(b) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的域名：

序號	擁有人	域名	註冊日期
1.	本公司	alkaidsemi.com	2025年4月18日

(c) 專利

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的專利：

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
1.	本公司	發明	雙柵控制型RC-IGBT 器件及其製備方 法	ZL202410690041.1	2024年 5月30日	2044年 5月30日	中國
2.	本公司	發明	結型場效應管控制 型RC-IGBT器件及 其製備方法	ZL202410690034.1	2024年 5月30日	2044年 5月30日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
3.	本公司	發明	具有自動增益控制功能的音頻編解碼裝置、方法和系統	ZL202410132693.3	2024年 1月30日	2044年 1月30日	中國
4.	本公司	發明	具有聲源定向功能的音頻編解碼裝置、方法及系統	ZL202311762358.3	2023年 12月19日	2043年 12月19日	中國
5.	本公司	發明	一種音頻編解碼器及音頻編解碼系統	ZL202311093714.7	2023年 8月28日	2043年 8月28日	中國
6.	本公司	發明	一種高頻近場電流傳感器及探頭	ZL202310946271.5	2023年 7月28日	2043年 7月28日	中國
7.	本公司	發明	多層外延超結場效應晶體管及製備方法	ZL202310532280.X	2023年 5月11日	2043年 5月11日	中國
8.	本公司	發明	一種驅動電路及驅動芯片	ZL202310438809.1	2023年 4月21日	2043年 4月21日	中國
9.	本公司	發明	一種集成肖特基接觸的IGBT器件結構及其製備方法	ZL202310342649.0	2023年 3月31日	2043年 3月31日	中國
10.	本公司	發明	溝槽型MOSFET電場保護結構及製備方法	ZL202310287851.8	2023年 3月22日	2043年 3月22日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
11.	本公司	發明	溝槽型MOSFET電場屏蔽保護結構及製備方法	ZL202310286448.3	2023年 3月22日	2043年 3月22日	中國
12.	本公司	發明	一種高頻噪聲抑制電路	ZL202310246271.4	2023年 3月14日	2043年 3月14日	中國
13.	本公司	發明	碳化矽基MOSFET器件及製作方法	ZL202211644184.6	2022年 12月20日	2042年 12月20日	中國
14.	本公司	發明	高可靠性的碳化矽基MOSFET器件及其製作方法	ZL202211644189.9	2022年 12月20日	2042年 12月20日	中國
15.	本公司	發明	溝槽型超結場效應晶體管及其製備方法	ZL202211360807.7	2022年 11月2日	2042年 11月2日	中國
16.	本公司	發明	一種過流保護電路及芯片	ZL202211328153.X	2022年 10月27日	2042年 10月27日	中國
17.	本公司	發明	一種結溫測量電路及系統	ZL202211145700.0	2022年 9月20日	2042年 9月20日	中國
18.	本公司	發明	輸出鉗位保護模塊、方法、芯片及驅動保護系統	ZL202211138899.4	2022年 9月19日	2042年 9月19日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
19.	本公司	發明	振膜及MEMS麥克風	ZL202211002714.7	2022年 8月22日	2042年 8月22日	中國
20.	本公司	發明	提高超結結構外延生長穩定性及半導體器件製備的方法	ZL202210501406.2	2022年 5月9日	2042年 5月9日	中國
21.	本公司	發明	雙脈衝測試電路及雙脈衝測試方法	ZL202210426667.2	2022年 4月21日	2042年 4月21日	中國
22.	本公司	發明	MEMS麥克風及其製備方法	ZL202210418882.8	2022年 4月20日	2042年 4月20日	中國
23.	本公司	發明	MEMS麥克風及其製備方法	ZL202210418883.2	2022年 4月20日	2042年 4月20日	中國
24.	本公司	發明	一種SiC JBS器件及其製備方法	ZL202210171014.4	2022年 2月23日	2042年 2月23日	中國
25.	本公司	發明	一種SiC MOSFET器件的製備方法	ZL202210169853.2	2022年 2月23日	2042年 2月23日	中國
26.	本公司	發明	一種屏蔽柵溝槽場效應晶體管的製備方法	ZL202111582066.2	2021年 12月22日	2041年 12月22日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
27.	本公司	發明	MEMS麥克風及其製備方法	ZL202111114623.8	2021年 9月23日	2041年 9月23日	中國
28.	本公司	發明	一種大電流SiC肖特基功率二極管及其製備方法	ZL202111007254.2	2021年 8月30日	2041年 8月30日	中國
29.	本公司	發明	一種SiC肖特基功率二極管及其製備方法	ZL202111005103.3	2021年 8月30日	2041年 8月30日	中國
30.	本公司	發明	一種SiC肖特基功率二極管及其製備方法	ZL202111005198.9	2021年 8月30日	2041年 8月30日	中國
31.	本公司	發明	一種SiC肖特基功率二極管及其製備方法	ZL202111007308.5	2021年 8月30日	2041年 8月30日	中國
32.	本公司	發明	一種MEMS麥克風結構及其製作方法	ZL202110439621.X	2021年 4月23日	2041年 4月23日	中國
33.	本公司	發明	一種功率開關器件結構及其製作方法	ZL202110383111.5	2021年 4月9日	2041年 4月9日	中國
34.	本公司	發明	屏蔽柵溝槽場效應晶體管結構及其製備方法	ZL202110358023.X	2021年 4月1日	2041年 4月1日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
35.	本公司	發明	一種集成PiN結構溫度傳感器的MOSFET器件及其製備方法	ZL202011322785.6	2020年 11月23日	2040年 11月23日	中國
36.	本公司	發明	一種基於外延溝道的MOSFET器件及其製備方法	ZL202011322803.0	2020年 11月23日	2040年 11月23日	中國
37.	本公司	發明	MEMS麥克風及其製備方法	ZL202011005047.9	2020年 9月23日	2040年 9月23日	中國
38.	本公司	發明	骨傳導聲音處理系統、骨傳導麥克風及其信號處理方法	ZL202010846221.6	2020年 8月21日	2040年 8月21日	中國
39.	本公司	實用新型	一種標準單元版圖結構與芯片版圖結構	ZL202223118287.7	2022年 11月23日	2032年 11月23日	中國
40.	本公司	實用新型	一種Sigma-Delta調製器的版圖結構	ZL202222899469.6	2022年 11月1日	2032年 11月1日	中國
41.	本公司	實用新型	MEMS麥克風及其背極板	ZL202121833212.X	2021年 8月6日	2031年 8月6日	中國
42.	本公司	實用新型	MEMS麥克風及其背極板	ZL202121830903.4	2021年 8月6日	2031年 8月6日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	擁有人	類型	專利	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
43.	本公司	實用新型	MEMS麥克風	ZL202121637449.0	2021年 7月19日	2031年 7月19日	中國
44.	本公司	實用新型	一種熱電堆	ZL202121080654.1	2021年 5月19日	2031年 5月19日	中國
45.	本公司	實用新型	一種背進音式MEMS 麥克風結構及其 封裝結構	ZL202120368917.2	2021年 2月8日	2031年 2月8日	中國
46.	本公司	實用新型	一種MEMS麥克風結 構	ZL202022333076.X	2020年 10月19日	2030年 10月19日	中國
47.	本公司	實用新型	一種MEMS麥克風結 構	ZL202022333077.4	2020年 10月19日	2030年 10月19日	中國
48.	本公司	實用新型	柔性膜及矽麥克風	ZL202021592485.5	2020年 8月4日	2030年 8月4日	中國
49.	本公司	實用新型	柔性膜及矽麥克風	ZL202020509813.4	2020年 4月9日	2030年 4月9日	中國
50.	本公司	實用新型	MEMS麥克風	ZL202020367978.2	2020年 3月20日	2030年 3月20日	中國

附錄六

法定及一般資料

(d) 集成電路佈圖設計

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對業務屬重要的佈圖設計：

序號	申請人	設計名稱	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
1.	本公司	AK650SJ7D8	BS.245587608	2024年11月5日	2034年11月5日	中國
2.	本公司	AKY0TN10A	BS.24558031X	2024年10月15日	2034年10月15日	中國
3.	本公司	AS26BN65A	BS.245570020	2024年9月9日	2034年9月9日	中國
4.	本公司	AKW7CMK2A	BS.245562605	2024年8月16日	2034年8月16日	中國
5.	本公司	AKU0CM65A-D1	BS.245562575	2024年8月16日	2034年8月16日	中國
6.	本公司	AKV0CMK2A	BS.245562583	2024年8月16日	2034年8月16日	中國
7.	本公司	AKV1CMK2A	BS.245562591	2024年8月16日	2034年8月16日	中國
8.	本公司	AKY5GN4A	BS.245562567	2024年8月16日	2034年8月16日	中國
9.	本公司	AS22BN65A	BS.245552464	2024年7月18日	2034年7月18日	中國
10.	本公司	AKT6DK2AF	BS.245552456	2024年7月18日	2034年7月18日	中國
11.	本公司	AS23BN65A	BS.245552480	2024年7月18日	2034年7月18日	中國
12.	本公司	AS24BN65A	BS.245552510	2024年7月18日	2034年7月18日	中國
13.	本公司	AS25BN65A	BS.245552529	2024年7月18日	2034年7月18日	中國
14.	本公司	AKW6GN4A	BS.245542035	2024年6月14日	2034年6月14日	中國
15.	本公司	AKM6GN3A	BS.245542027	2024年6月14日	2034年6月14日	中國
16.	本公司	AS15SN65AF	BS.245542051	2024年6月14日	2034年6月14日	中國
17.	本公司	AKX7TN1AE	BS.245542043	2024年6月14日	2034年6月14日	中國
18.	本公司	AKQ3CMK2A-D1	BS.235610348	2023年12月22日	2033年12月22日	中國
19.	本公司	AKS8GN15A	BS.235615099	2023年12月29日	2033年12月29日	中國
20.	本公司	AKS6CMK2A	BS.235610380	2023年12月22日	2033年12月22日	中國
21.	本公司	AS09SN65AF	BS.235615110	2023年12月29日	2033年12月29日	中國
22.	本公司	AS08SN65AF	BS.235615102	2023年12月29日	2033年12月29日	中國
23.	本公司	AKS7CMK2A	BS.235610399	2023年12月22日	2033年12月22日	中國
24.	本公司	AKD9BN65A	BS.235596639	2023年11月20日	2033年11月20日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	申請人	設計名稱	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
25.	本公司	AKR4BNK2A	BS.235596663	2023年11月20日	2033年11月20日	中國
26.	本公司	AKU2D65AF	BS.235596671	2023年11月20日	2033年11月20日	中國
27.	本公司	AKT0TP4B	BS.235585068	2023年10月13日	2033年10月13日	中國
28.	本公司	AKT0TP4A	BS.23558505X	2023年10月13日	2033年10月13日	中國
29.	本公司	AKK9CMK7A-D1	BS.235574287	2023年9月7日	2033年9月7日	中國
30.	本公司	AKN8CM65A	BS.235574295	2023年9月7日	2033年9月7日	中國
31.	本公司	AKD8BNK2B	BS.235574317	2023年9月7日	2033年9月7日	中國
32.	本公司	AKE9CMK2A	BS.235569038	2023年8月23日	2033年8月23日	中國
33.	本公司	AK1K2FR1D1	BS.235574309	2023年9月7日	2033年9月7日	中國
34.	本公司	AKH9CMK2A	BS.235568961	2023年8月23日	2033年8月23日	中國
35.	本公司	AKR3DNK2AF	BS.235574325	2023年9月7日	2033年9月7日	中國
36.	本公司	AKT4GN4A	BS.235565180	2023年8月11日	2033年8月11日	中國
37.	本公司	AKE8CMK2A	BS.23556902X	2023年8月23日	2033年8月23日	中國
38.	本公司	AKN7CM65A	BS.235568988	2023年8月23日	2033年8月23日	中國
39.	本公司	AKP5GN6A	BS.235546593	2023年6月16日	2033年6月16日	中國
40.	本公司	AKE0D65AF	BS.235553190	2023年7月6日	2033年7月6日	中國
41.	本公司	AKP8GN4A	BS.235553204	2023年7月6日	2033年7月6日	中國
42.	本公司	AKD6BNK2B	BS.235536148	2023年5月19日	2033年5月19日	中國
43.	本公司	AK1K2FRD77	BS.235536156	2023年5月19日	2033年5月19日	中國
44.	本公司	AK1K2FR1D9	BS.235531472	2023年5月6日	2033年5月6日	中國
45.	本公司	AKD7BNK2B	BS.235531480	2023年5月6日	2033年5月6日	中國
46.	本公司	AKM5GN6A	BS.235521256	2023年4月6日	2033年4月6日	中國
47.	本公司	AKE6CMK2A-GR	BS.235513296	2023年3月6日	2033年3月6日	中國
48.	本公司	AKA0801_DBH	BS.235503584	2023年1月28日	2033年1月28日	中國
49.	本公司	AKA7TN4A	BS.235501166	2023年1月6日	2033年1月6日	中國
50.	本公司	AKA2T4A	BS.23550114X	2023年1月6日	2033年1月6日	中國
51.	本公司	AK96T2A	BS.235501131	2023年1月6日	2033年1月6日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	申請人	設計名稱	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
52.	本公司	AKF6TN6A	BS.225623110	2022年12月2日	2032年12月2日	中國
53.	本公司	AK95T4A	BS.225627159	2022年12月14日	2032年12月14日	中國
54.	本公司	AG01GN10A	BS.225627132	2022年12月14日	2032年12月14日	中國
55.	本公司	AKA0108_E	BS.225615428	2022年11月9日	2032年11月9日	中國
56.	本公司	AKA1CDK2A-DA-D6	BS.22561541X	2022年11月9日	2032年11月9日	中國
57.	本公司	AKK6GN10A	BS.225605538	2022年10月11日	2032年10月11日	中國
58.	本公司	AK95T4A	BS.225605481	2022年10月11日	2032年10月11日	中國
59.	本公司	AKK5GN15A	BS.225605511	2022年10月11日	2032年10月11日	中國
60.	本公司	AKH5GN3A	BS.225603381	2022年9月30日	2032年9月30日	中國
61.	本公司	AKH8GN3A	BS.22560339X	2022年9月30日	2032年9月30日	中國
62.	本公司	AKA1CDK2A-DA-D4	BS.225588099	2022年8月17日	2032年8月17日	中國
63.	本公司	AKA0106M2D	BS.225578158	2022年7月19日	2032年7月19日	中國
64.	本公司	AKB2G4A	BS.225578166	2022年7月19日	2032年7月19日	中國
65.	本公司	AKE1CD65A-C1	BS.225572532	2022年7月4日	2032年7月4日	中國
66.	本公司	AK80G3A	BS.225561514	2022年6月9日	2032年6月9日	中國
67.	本公司	AKA6G10A	BS.225561522	2022年6月9日	2032年6月9日	中國
68.	本公司	AK15NE70D	BS.225552507	2022年5月17日	2032年5月17日	中國
69.	本公司	AK20NE25D	BS.225552523	2022年5月17日	2032年5月17日	中國
70.	本公司	AK15NE110D	BS.225552515	2022年5月17日	2032年5月17日	中國
71.	本公司	AKE1CD65A-A1	BS.225536188	2022年4月5日	2032年4月5日	中國
72.	本公司	信號調理數字接口 芯片AKA02062	BS.225501546	2022年1月6日	2032年1月6日	中國
73.	本公司	信號調理芯片 AKA01062	BS.225501457	2022年1月6日	2032年1月6日	中國

附錄六

法定及一般資料

序號	申請人	設計名稱	註冊編號	申請日期	屆滿日期	申請地點
74.	本公司	信號調理芯片 AKA0108	BS.225501503	2022年1月6日	2032年1月6日	中國
75.	本公司	AKE1CD65A-B1	BS.225536196	2022年4月5日	2032年4月5日	中國
76.	本公司	信號調理芯片 AKA01066	BS.225513056	2022年1月28日	2032年1月28日	中國
77.	本公司	AKM2A31	BS.225512610	2022年1月27日	2032年1月27日	中國
78.	本公司	信號調理芯片 AKA01065	BS.225513048	2022年1月28日	2032年1月28日	中國
79.	本公司	AKC650D6-A37	BS.225512874	2022年1月27日	2032年1月27日	中國
80.	本公司	AKA4G4A	BS.225512882	2022年1月27日	2032年1月27日	中國
81.	本公司	AKC1K2M20-A39	BS.225512866	2022年1月27日	2032年1月27日	中國
82.	本公司	信號調理數字接口 芯片AKA02061	BS.22550152X	2022年1月6日	2032年1月6日	中國
83.	本公司	AS45SN65A	BS.245603948	2024年12月22日	2034年12月22日	中國
84.	本公司	AKA0807_A1	BS.245603956	2024年12月22日	2034年12月22日	中國
85.	本公司	AKX4CMK2A	BS.245606459	2024年12月29日	2034年12月29日	中國
86.	本公司	AKT7DK2AF	BS.245606467	2024年12月30日	2034年12月30日	中國
87.	本公司	AKT8DK2AF	BS.245606475	2024年12月30日	2034年12月30日	中國
88.	本公司	AKZ2GN6A	BS.245606483	2024年12月30日	2034年12月30日	中國
89.	本公司	AKZ6GN6A	BS.245606491	2024年12月30日	2034年12月30日	中國
90.	本公司	AS11BNK2A	BS.245606505	2024年12月30日	2034年12月30日	中國
91.	本公司	AW01TP1A	BS.245606513	2024年12月30日	2034年12月30日	中國

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他與我們的業務有關的重大商標或服務標識、專利、知識產權或工業產權。

有關董事及主要股東的進一步資料

1. 權益披露

除下文所披露者外，就董事所知，緊隨[編纂]完成後(並無計及因超額配股權獲行使而可能配發及發行的H股)，概無任何董事及最高行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文彼等被當作或視作擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所指登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。

董事/ 最高行政人員 姓名/名稱	職位	權益性質	股份數目 及類別	佔相關股份 類別的概約 持股百分比 ⁽¹⁾	佔本公司股本 總額的概約 持股百分比 ⁽¹⁾
郭博士 ⁽²⁾	董事會主席、執行 董事、首席執行官 兼總經理	於受控法團權益	84,838,770股H股	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 計算乃根據緊隨[編纂]及股份拆細完成後的[編纂]股已發行H股總數(假設[編纂]未獲行使)得出。股份數目以股份拆細完成為假設呈列。
- (2) 郭博士為睿氏芯的普通合夥人。因此，根據證券及期貨條例，郭博士被視為於睿氏芯持有的股份中擁有權益。

2. 主要股東

有關於緊隨[編纂]完成後將在本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的條文須向本公司及香港聯交所披露的權益或淡倉的人士資料，請參閱本文件「主要股東」。

3. 服務合約

各董事均[已]與本公司訂立服務合約。該等服務合約的主要內容包括：(a)任期自本公司相關股東大會批准之日起開始，至應屆董事會任期屆滿為止(就董事而言)；及(b)根據其各自條款訂立的終止條文。

除上文所披露者外，概無董事已與或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務合約（於一年內到期或本集團任何成員公司可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合約除外）。

4. 董事薪酬

除本文件「董事及高級管理層」一節及會計師報告附註14所披露者外，於截至2023年、2024年及2025年12月31日止財政年度，概無董事自我們取得其他實物利益薪酬。

5. 免責聲明

- (a) 除本節及本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，董事及本附錄「其他資料—5.專家資格」一段所述的任何一方均無：
- (i) 於我們的發起中，或於緊接本文件日期前兩年內由我們收購或處置或租賃或擬由本公司任何成員公司收購或處置或租賃的任何資產中擁有權益；或
 - (ii) 在本文件日期仍然有效且與我們業務有重大關係的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (b) 除與[編纂]及[編纂]相關者外，本附錄「其他資料—5.專家資格」一段所列各方：
- (i) 均無於本集團任何成員公司任何股份中擁有法定或實益權益；或
 - (ii) 亦無擁有可認購或提名他人認購本集團任何成員公司任何證券的任何權利（不論可否依法強制執行）；
- (c) 除本節及本文件「董事及高級管理層」一節所披露者外，概無董事於任何一家於本公司股本中擁有權益的公司擔任董事或僱員，而該等權益於H股在香港聯交所[編纂]後須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須予以披露；及
- (d) 就董事所知，概無董事或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）或擁有本公司已發行股份5%以上的股東於本集團前五大客戶或前五大供應商中擁有任何權益。

員工持股平台

為表揚我們的員工的貢獻，並激勵他們進一步推動本公司的發展，本公司成立了睿氏芯、上海鏞駿、上海燕釘及上海玉衡芯作為我們的員工持股平台。截至最後實際可行日期，睿氏芯持有本公司已發行股份總數約49.78%，而上海鏞駿、上海燕釘及上海玉衡芯分別持有睿氏芯9.91%、2.65%及1.14%的合夥權益。睿氏芯、上海鏞駿及上海燕釘各自受2021年股份激勵計劃(定義見下文)規管，而上海玉衡芯則受2025年股份激勵計劃(定義見下文)規管。由於該等激勵計劃並不涉及本公司於[編纂]後授出新股份或獎勵，故均毋須遵守上市規則第17章的規定。

2021年股份激勵計劃

(a) 目的

根據於2021年11月26日採納的員工股份激勵計劃(「**2021年股份激勵計劃**」)，2021年股份激勵計劃的目的是加強企業管治及建立結構化的長期激勵制度。其目的在於加強管理層及核心員工的責任感和使命感，促進公司穩定成長，支持公司實現長期戰略目標。

(b) 合資格參與者

合資格參與者包括本公司共同創辦人、本公司董事、高級管理人員及員工、本公司外部顧問或2021年股份激勵計劃管理人認為對本公司經營業績及未來發展有重大影響的任何員工。

(c) 調整

在任何資本儲備轉換為本公司股份的情況下，參與者通過睿氏芯、上海鏞駿及上海燕釘間接持有的獲授股份數目可由2021年股份激勵計劃管理人作相應調整。

(d) 禁售

根據適用的中國法律及上市規則，2021年股份激勵計劃的參與者須遵守自2021年股份激勵計劃之日起至[編纂]後12個月屆滿為止的禁售期。在此期間內，參與者不得轉讓、質押或將股份用作抵押。

(e) 特殊情況下的處理

倘參與者(i)自願辭職，(ii)身故，(iii)違反任何適用的法律法規或僱傭合同，或(iv)因任何不當行為或疏忽而被解僱，2021年股份激勵計劃的管理人有權回購參與者持有的所有獎勵。

2025年股份激勵計劃

(a) 目的

根據於2025年7月21日採納的員工股份激勵計劃（「**2025年股份激勵計劃**」），2025年股份激勵計劃的目的是加強企業管治及建立結構化的長期激勵制度。其目的在於加強管理層及核心員工的責任感和使命感，促進公司穩定成長，支持公司實現長期戰略目標。

(b) 合資格參與者

合資格參與者包括本公司共同創辦人、本公司董事、高級管理人員及員工或2025年股份激勵計劃管理人認為對本公司經營業績及未來發展有重大影響的任何員工。

(c) 調整

在任何資本儲備轉換為本公司股份的情況下，參與者通過上海玉衡芯間接持有的獲授股份數目可由2025年股份激勵計劃管理人作相應調整。

(d) 禁售

根據適用的中國法律及上市規則，2025年股份激勵計劃的參與者須遵守自2025年股份激勵計劃之日起至[編纂]後12個月屆滿為止的禁售期。在此期間內，參與者不得轉讓、質押或將股份用作抵押。

(e) 特殊情況下的處理

倘參與者(i)自願辭職，(ii)身故，(iii)違反任何適用的法律法規或僱傭合同，或(iv)因任何不當行為或疏忽而被解僱，2025年股份激勵計劃的管理人有權回購參與者持有的所有獎勵。

附錄六

法定及一般資料

授予獎勵的詳情

截至本文件日期，我們的員工持股平台的參與者詳情載列如下：

參與者姓名	在本集團內的職位	持股平台	截至本文件日期	
			佔相關平台所持權益的概約百分比	在相關平台所持權益對應已發行股份總數所佔概約持股百分比
董事				
郭博士	董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理	睿氏芯	51.64%	25.71%
		上海鏞駿	0.51%	0.03%
李衛剛先生	執行董事兼副總經理	睿氏芯	17.47%	8.70%
		上海鏞駿	0.51%	0.03%
陳開宇先生	執行董事兼副總經理	睿氏芯	1.83%	0.91%
李鑫先生	執行董事、副總經理兼首席財務官	睿氏芯	9.64%	4.80%
王一鳴先生	執行董事	上海燕釘	18.99%	0.25%
高級管理層				
王青松先生	副總經理	睿氏芯	5.07%	2.52%
鄭召星先生	副總經理	睿氏芯	0.66%	0.33%
羅希女士	副總經理	上海玉衡芯	63.89%	0.36%
王曙先生	董事會秘書	上海鏞駿	2.03%	0.10%
其他參與者				
其他50名參與者	員工及前員工	上海鏞駿	96.95%	4.78%
		上海燕釘	81.01%	1.07%
		上海玉衡芯	36.11%	0.20%

附註：為說明承授人於本公司的間接權益，股份數目以其各自所佔有限合夥權益百分比乘以相關員工持股平台所持有的股份總數呈列及計算。

其他資料

1. 遺產稅

董事已獲悉，根據中國法律，本公司或我們的任何附屬公司無需承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或申索，且據我們所知，本集團任何成員公司概無尚未了結或面臨威脅而將會對我們的整體財務狀況或經營業績產生重大不利影響的任何重大訴訟、仲裁或申索。

3. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所申請批准H股[編纂]及[編纂]。我們已作出一切必要安排，以使證券獲納入中央結算系統。

聯席保薦人符合上市規則第3A.07條所載的適用於保薦人的獨立性標準。各聯席保薦人將就擔任本公司[編纂]的保薦人獲得500,000美元的費用。

4. 開辦費用

截至最後實際可行日期，本公司並無產生重大開辦費用。

5. 專家資格

提供本文件所載意見及／或建議的專家(定義見上市規則及公司(清盤及雜項條文)條例)的資格如下：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團
招商證券(香港)有限公司	根據證券及期貨條例可進行證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌法團

(排名不分先後)

名稱	資格
香港立信德豪會計師事務所有限公司	根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公眾利益實體核數師
錦天城律師事務所	本公司中國法律顧問
灼識行業諮詢有限公司	獨立行業顧問

6. 同意書

本附錄「一 其他資料-5. 專家資格」一段所提述的各專家均已就本文件的刊發發出彼等各自的同意書，同意按其各自所列形式及內容載入其證書、函件、意見或報告及提述彼等各自的名稱，且迄今並未撤回彼等各自的同意書。

7. H股持有人的稅務

(a) 香港

出售、購買及轉讓H股須繳納香港印花稅。現時向買賣雙方徵收的費率為代價或已出售或轉讓的H股的公允價值(以較高者為準)的0.1%。有關稅項的進一步詳情，請參閱本文件附錄四。

(b) 諮詢專業顧問的意見

[編纂]的有意投資者對認購、購買、持有或處置或[編纂]H股(或行使其所附帶的權利)的稅務影響如有任何疑問，謹請諮詢彼等的專業稅務顧問。本公司、董事、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]，或參與[編纂]的任何其他人士或各方概不對任何人士因認購、購買、持有或處置、[編纂]本公司H股或行使與本公司H股有關的任何權利而引致的任何稅務影響或責任負責。

8. 無重大不利變動

董事確認，自2025年12月31日(即會計師報告所載綜合財務報表的最近期資產負債表日期)起直至本文件日期，本公司的財務或經營狀況並無重大不利變動。

9. 發起人

本公司的發起人為截至2024年12月5日我們改制為股份有限公司之前本公司當時的所有44名股東。除本文件「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，於本文件日期前兩年內，概無就本文件所述的[編纂]及關聯交易而曾向或擬向任何發起人支付、配發或給予任何現金、證券或其他利益。

10. 回購限制

詳情請參閱本文件附錄四及五。

11. 約束力

倘依據本文件提出申請，本文件即具效力，使一切有關人士須受公司(清盤及雜項條文)條例第44A條及第44B條的所有適用條文(刑事條文除外)約束。

12. 雙語文件

根據香港法例第32L章公司(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第4條的豁免規定，本文件分別以英文及中文刊發。

13. 其他事項

除本文件另有披露者外：

- (a) 於本文件日期前兩年內，(i)本公司概無發行或同意發行繳足或部分繳足的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的代價；及(ii)本公司概無就發行或出售任何股份而授出任何佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (b) 本公司的股本或借貸資本(如有)概無附有購股權，亦無有條件或無條件同意附有購股權；
- (c) 本公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (d) 本公司概無任何未行使可換股債務證券或債權證；
- (e) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 於過往12個月，我們的業務不曾出現可能或已經對財務狀況造成重大影響的中斷事件；
- (g) 本公司目前未在任何證券交易所上市或於任何交易系統進行交易；及
- (h) 本公司為一家股份有限公司，須遵守《中國公司法》。